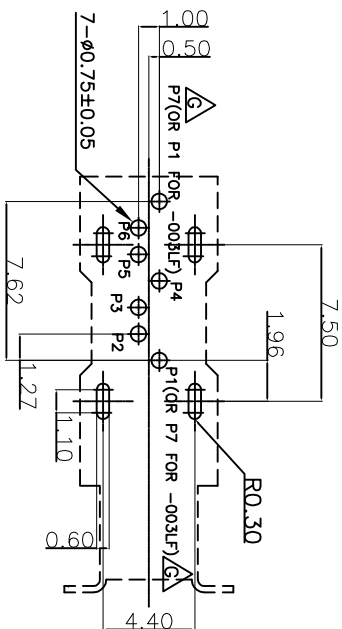
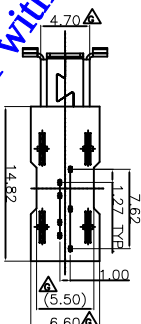
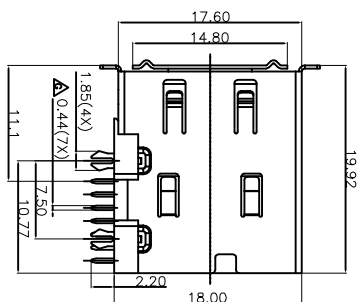
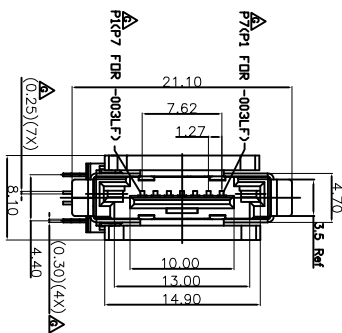


PRODUCT NO.
10074141-001LF
10074141-003LF



PIN DEFINITION

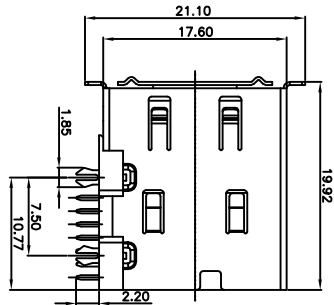
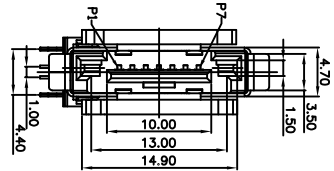
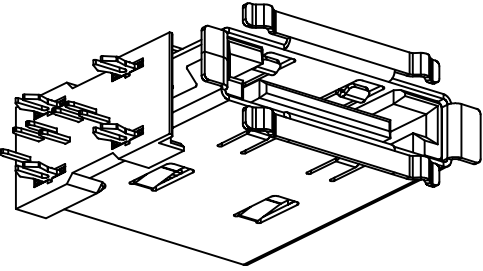
ESATA	NAME	TYPE
P1	GND	
P2	A+	
P3	A-	
P4	GND	
P5	B-	
P6	B+	
P7	GND	

RECOMMEND P.C. BOARD LAYOUT PCB TOLERANCE:±0.05

mat'l. code	14	surface	sg	tolerance	projection	product family
lfr	ecp no	dr	date	ISO 1302	ISO 406	ISO 101
A	107-1074S	LNK	2007-05-23	angle	.XX±0.38	MM
B	108-1082S	LNK	2008-04-28	linear	.XX±0.25	MM
C	110-0184S	LNK	2010-12-14	0°±2°	.XXX±0.100	scale 2:1
D	1-00544QS	LNK	2011-08-31	STERLING	LNK	2007-05-21
E	EX-S-007881	HKL	2011-10-17	ENG	HKLIM	2016-03-03
F	EX-S-011878	HKL	2012-06-08	CH	HKLIM	2016-03-03
G	EX-S-23469	HKL	2016-03-03	QPP	KPTAY	2016-03-03
sheet	revision	G	G	107	109	111
index	sheet	1	2	3	106	108
					110	112
					114	116
					118	120
					122	124
					126	130
					132	134
					136	138

PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools

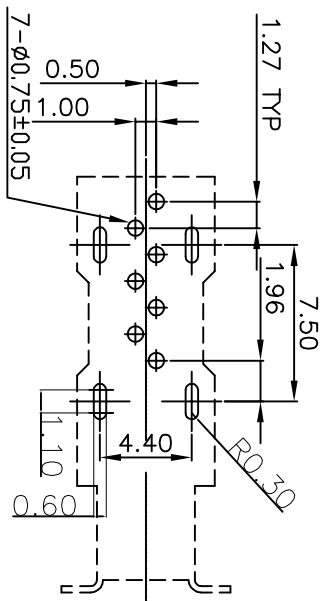
- NOTES:
1. MATERIAL: HOUSING-THERMAL/PLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F UL94 V-0
 2. FINISH: 500" MIN. MAT TIN PLATING ON SOLDERABLES
 3. THE HOUSING WILL WITHSTAND TO 260C FOR 10 SEC IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6MM PCB
 4. PRODUCT SPEC : GS-12-386
 5. PACKING SPEC : GS-14-1109
 6. A SYMBOL Δ WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION
- PACKING: TRAY PACKING
1. 150" GOLD PLATING
2. 0/F GOLD PLATING
3. 150" GOLD PLATING WITH NEW PINOUT ASSIGNMENT
0. LAYOUT#1
- 10074141-001LF LEAD FREE



PIN DEFINITION

NAME	TYPE
P1	GND
P2	A+
P3	A-
P4	GND
P5	B-
P6	B+
P7	GND

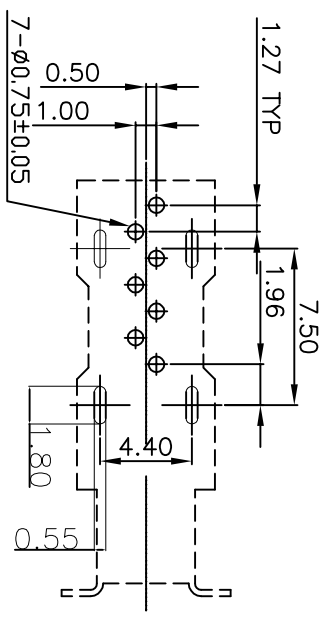
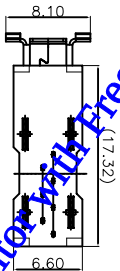
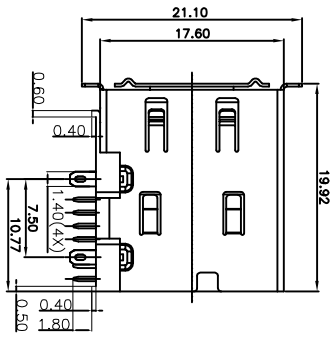
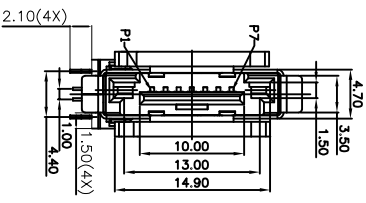
PDFFill PDF Editor with Free Writer and Tools



P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS T=1.60mm
PCB TOLERANCE: ±0.05

- NOTES:
1. MATERIAL:
HOUSING: THERMAL PLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F UL94 V-0
CONTACT: COPPER ALLOY
SHELL: BOARD LOCK: COPPER ALLOY
COLOR: BLACK
 2. FINISH:
CONTACT: GOLD PLATING ON CONTACT AREA
100µ" MIN. MATT TIN PLATING ON SOLDERMATS
50µ" MIN. NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
BOARD LOCK: 50µ" MIN. NICKEL TIN PLATING OVER ALL
SHELL/BOARD LOCK: 50µ" MIN. NICKEL PLATING OVER ALL
3. IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5MM PCB
 4. PRODUCT SPEC : GS-12-386
 5. PACKING SPEC : GS-14-1109
 6. PRODUCT NUMBERING:
10074141 - 1 0 1 1 0 9 LF LEAD FREE
- 1: LAYOUT#2
- 1: 150µ" GOLD PLATING
2: G/F GOLD PLATING
- PACKING:
BLANK: TRAY PACKING
6. A SYMBOL Δ WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE, WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION

mat'l. code	14	surface	sg	tolerance	projection	product family	533
lfr	ecn no	dr	date	ISO 1302	ISO 406	ISO 101	
A	107-1074S	LNK	2007-05-23	tolerances unless otherwise specified	.X±0.38	MM	
B	108-1082S	LNK	2008-04-28	linear	.XX±0.25	MM	
C	110-0184S	LNK	2010-12-14	0°±2°	.XXX±0.100	scale 2:1	
D	1-00544QS	LNK	2011-08-31	STERLING	LNK	2007-05-21	
E	EX-5-0078H	HKL	2011-10-17	ENG	HKLIM	2016-03-03	
F	EX-5-0118H	HKL	2012-06-08	CH	HKLIM	2016-03-03	
G	EX-5-254H	HKL	2016-03-03	DPD	KPTAY	2016-03-03	
sheet	revision	G	G	G	107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139	type	PRODUCT-CUSTOMER.DRW Drawing
index	sheet	1	2	3	106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138	sheet no	10074141
						sheet 2 of 3	size A3



P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS T=1.60mm

PCB TOLERANCE: ±0.05

PIN DEFINITION	
NAME	TYPE
P1	GND
P2	A+
P3	A-
P4	GND
P5	B-
P6	B+
P7	GND

- NOTES:
1. MATERIAL: THERMOPLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F UL94 V-0
 2. FINISH: CONTRACT GOLD PLATING ON CONTACT AREA
 3. THE HOUSING WILL WITHSTAND TO 260C FOR 10 SEC IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5MM PCB
 4. PRODUCT SPEC : 05-12-386
 5. PACKING SPEC : 05-14-1109
 6. A SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE, WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION

mat'l. code		surface ss		tolerance		projection		product family	
14	14	ISO 1302	ISO 406	ISO 101	ISO 101	MM	MM	533	
ltr	ecn no	date	tolerances unless otherwise specified	angle	linear	scale	2:1	E-SATA_UP_RIGHT	
A	107-1074S.LIN	2007-05-23			.XX±0.38			DIP_TYPE	
B	108-1082S.LIN	2008-04-28			.XX±0.25				
C	110-0184S.LIN	2010-12-14	0°±2°		.XXX±0.100				
D	1-00544QS.LIN	2011-08-31	STERLING.LIN	2007-05-21					
E	EX-S-007881	HKL	2011-10-17	ENG	HKLIM	2016-03-03			
F	EX-S-011878	HKL	2012-06-08	CH	HKLIM	2016-03-03			
G	EX-S-23469	HKL	2016-03-03	QPP	KPTAY	2016-03-03			
Sheet	revision	1	2	3	107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139				
index	sheet	G	G	G	106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138				

PDFFill PDF Editor with Free Writer and Tools

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9